

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部成分表

製品名(鉛フリー): XC6701A/BxxxMR-G

標準質量: 16 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.617	シリコン	38500	7440-21-3
リードフレーム	5.503	銅	343900	7440-50-8
	0.022	錫	1400	7440-31-5
	0.021	亜鉛	1300	7440-66-6
	0.024	クロム	1500	7440-47-3
	0.325	銀	20300	7440-22-4
ダイアタッチ	0.049	銀	3100	7440-22-4
	0.009	エポキシ	600	—
ボンディングワイヤ	0.030	金	1900	7440-57-5
封止樹脂	7.356	溶融シリカ	459700	60676-86-0
	0.699	エポキシ樹脂	43700	—
	0.588	フェノール樹脂	36700	—
	0.418	金属水酸化物	26100	—
端子メッキ	0.340	錫	21300	7440-31-5

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせて頂いております。